



SMD 型片式热敏电阻器

编 号	STE-WI-022-04	制订日期	2025 年 07 月 10 日
发行版次	V 1.0	页 次	第 1 页 共 15 页

规格承认书

客户名称：深圳市立创电子商务有限公司

客户料号：

松田料号：ST10603X103F3380FB

规格型号：0603-103F-3380F

★ 产品环保要求：RoHS

★ 产品包装方式：编带

制 作	客户确认（签署）
李光钦	
审 核	
胡 勇	
批 准	
赵明辉	

（签认后，敬请惠还一份）



汕头保税区松田电子科技有限公司
SHANTOU FREE TRADE ZONE SONGTIAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

Http://www.songtian.cn

地址：汕头保税区松田科技园东区、松田科技园西区

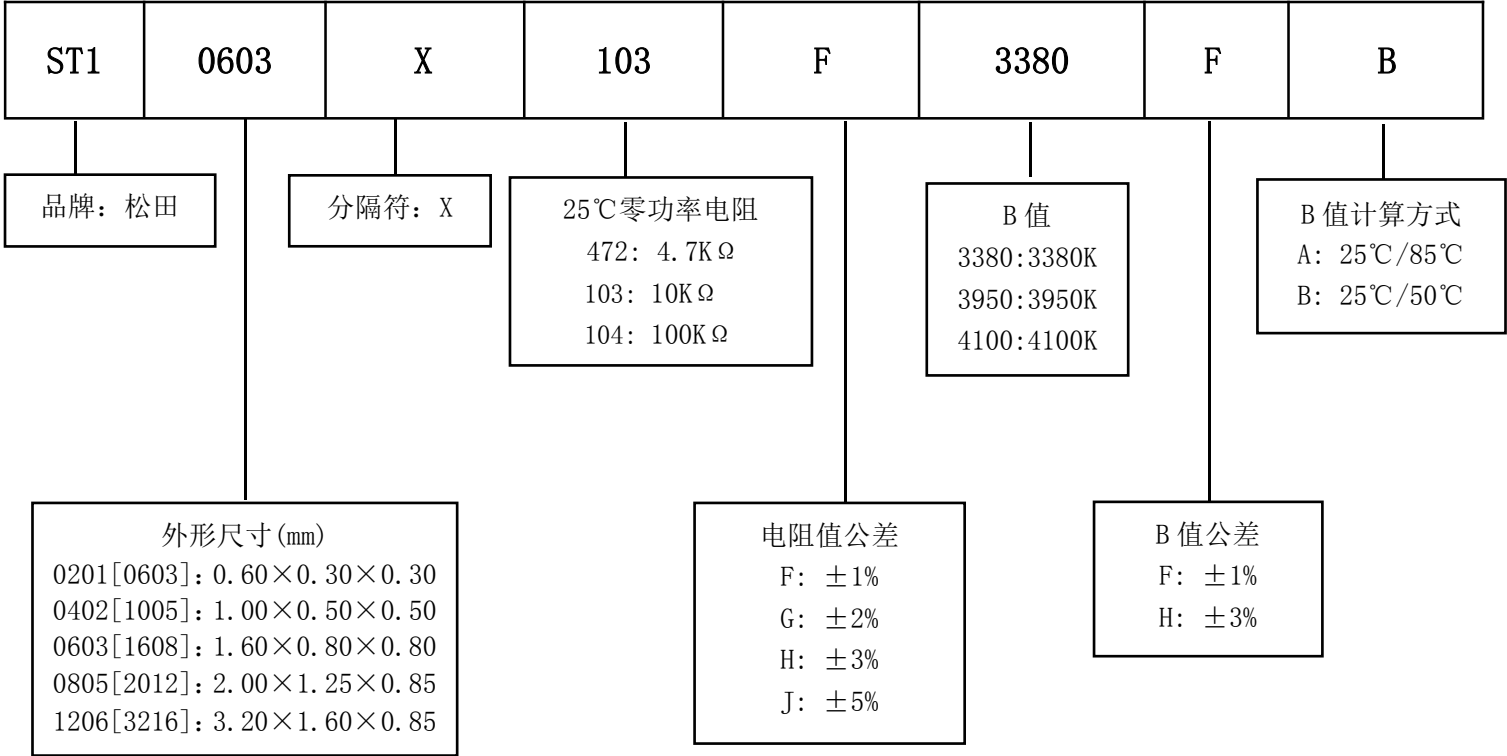
电话：86-754-88266532 传真：86-754-88266546

E-mail:888@songtian.cn 邮编：515071

变更履历表

序号	日期	版本	变更原因	描述
1	2025. 7. 10	A 版	/	第一次承认
2				
3				
4				
5				
6				
7				

一、料号编码原则



二、外形尺寸

■尺寸：见图 1 和表 1

■PCB 焊盘：见图 2 和表 1

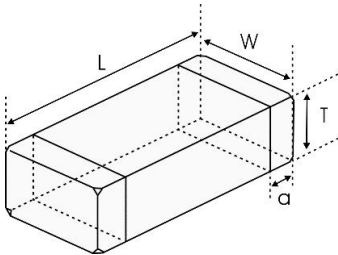


图 1

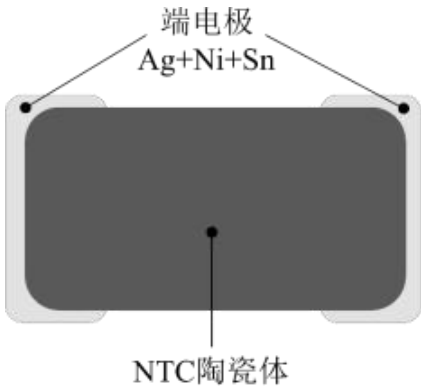


图 2

表 1					单位 unit: mm
类别	L	W	T	a	
0603	1.6±0.15	0.8±0.15	0.8±0.15	0.4±0.2	

	SMD 型片式热敏电阻器			
	编 号	STE-WI-022-04	制订日期	2025 年 07 月 10 日
	发行版次	V 1.0	页 次	第 4 页 共 15 页

三、电气特性

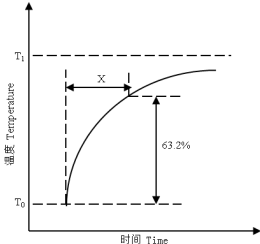
型号	电阻值 (25℃) (kΩ)	B 常数 (25/50℃) (K)	B 常数 (25/85℃) (K)	允许工作电流 (25℃) (mA)	耗散系数 (mW/℃)	热时间常数 (s)	额定功率 (mW)	工作温度 (℃)
ST10603X103F3380FB	10±1%	3380±1%	3435 ref.	0.31	1.0	<5	100	-40~+125

* 在 25℃静止空气中，贴装到 PCB 板上进行测试。

四、检验和测试程序

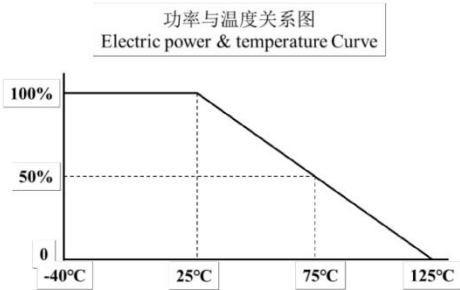
- 测试条件（如无特别规定，检验和测试的标准大气环境条件如下）：
 - a. 环境温度：20±15℃； b. 相对湿度：65±20%； c. 气压：86kPa~106kPa。
- 如果对测试结果有异议，则在下述条件下测试：
 - a. 环境温度：25±2℃； b. 相对湿度：65±5%； c. 气压：86kPa~106kPa。
- 检查设备：外观检查：20 倍放大镜； 阻值检查：热敏电阻测试仪。

五、电性测试

序号	项目	测试方法及备注
1	25℃零功率电阻值	环境温度：25±0.05℃ 测试功率：≤0.1mW
2	B 值常数	分别在环境温度 25±0.05℃， 50±0.05℃或 85±0.05℃下测量电阻值。 $B(25-50℃)=(\ln R_{25}-\ln R_{50})/(1/T_{25}-1/T_{50})$ $B(25-85℃)=(\ln R_{25}-\ln R_{85})/(1/T_{25}-1/T_{85})$ T：绝对温度 (K)
3	热时间常数	在零功率条件下，当热敏电阻的环境温度发生急剧变化时，热敏电阻元件产生最初温度 T0 与最终温度 T1 两者温度差的 63.2% 的温度变化所需要的时间，通常以秒 (S) 表示。 
4	耗散系数	在一定环境温度下，NTC 热敏电阻通过自身发热使其温度升高 1℃时所需要的功率，通常以 mW/℃表示。可由下面公式计算： $\delta = W/(T-T_0)$
5	额定功率	在环境温度 25℃下因自身发热使表面温度升高 100℃所需要的功率。
6	允许工作电流	在静止空气中通过自身发热使其升温为 1℃的电流。

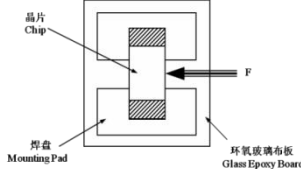
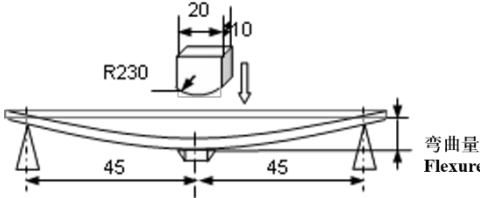
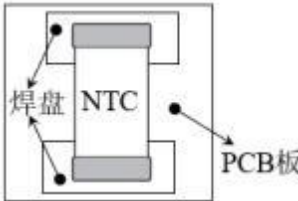
注：在 25℃的静止空气中给 NTC 热敏电阻施加 100mW 的额定功率，NTC 热敏电阻会升温 100℃左右。但太快的升温速度可能会导致 NTC 热敏电阻意外失效，因此请不要短时间内给其施加大于 10mW 的功率（10mW 的功率会让 NTC 热敏电阻升温 10℃左右）。建议电流小于允许工作电流值的 1/10 以防止 NTC 热敏电阻自热。

功率与工作温度的关系如下图所示：



	SMD 型片式热敏电阻器			
	编 号	STE-WI-022-04	制订日期	2025 年 07 月 10 日
	发行版次	V 1.0	页 次	第 5 页 共 15 页

六、可靠性试验

项目	测试方法及备注	要求										
端头附着力	将 NTC 焊接在测试基板上（如右图所示的环氧玻璃布板），按箭头所示方向施加作用力。 <table><tr><th>尺寸</th><th>F</th><th>保持时间</th></tr><tr><td>0201</td><td>2N</td><td rowspan="3">10±1s</td></tr><tr><td>0402, 0603</td><td>5N</td></tr><tr><td>0805</td><td>10N</td></tr></table>	尺寸	F	保持时间	0201	2N	10±1s	0402, 0603	5N	0805	10N	端电极无脱落且瓷体无损伤。 
尺寸	F	保持时间										
0201	2N	10±1s										
0402, 0603	5N											
0805	10N											
抗弯强度	将晶片焊接在测试基板上（如右图所示的环氧玻璃布板），按下图箭头所示方向施加作用力；  <table><tr><th>尺寸</th><th>弯曲变形量</th><th>施压速度</th><th>保持时间</th></tr><tr><td>0201</td><td>1mm</td><td rowspan="2"><0.5mm/s</td><td rowspan="2">10±1s</td></tr><tr><td>0402, 0603, 0805</td><td>2mm</td></tr></table>	尺寸	弯曲变形量	施压速度	保持时间	0201	1mm	<0.5mm/s	10±1s	0402, 0603, 0805	2mm	无外观损伤； ΔR25/R25 ≤2% ΔB/B ≤1%
尺寸	弯曲变形量	施压速度	保持时间									
0201	1mm	<0.5mm/s	10±1s									
0402, 0603, 0805	2mm											
振动	将晶片焊接在测试基板上（如右图所示的环氧玻璃布板）； 晶片以全振幅为 1.5mm 进行振动，频率范围为 10Hz～55Hz； 振动频率按 10Hz→55Hz→10Hz 循环，周期为 1 分钟，在空间三个互相垂直的方向上各振动 2 小时（共 6 小时）。 	无外观损伤； ΔR25/R25 ≤2% ΔB/B ≤1%										
坠落	从 1m 的高度让 NTC 自由坠落至水泥地面 10 次。	无外观损伤。										
可焊性	焊接温度：245±5℃. 浸渍时间：3.0±0.3s. 焊锡成分：96.5 Sn/3.0Ag/0.5Cu. 助焊剂：（重量比）25%松香和 75%酒精	无外观损伤； 元件端电极的焊锡覆盖率不小于 95%。										
耐焊性	焊接温度：260±5℃. 浸渍时间：10±1s. 焊锡成分：96.5 Sn/3.0Ag/0.5Cu. 助焊剂：（重量比）25%松香和 75%酒精 试验后标准条件下放置 1~2 小时后测量。	无外观损伤； ΔR25/R25 ≤2% ΔB/B ≤1%										

	SMD 型片式热敏电阻器			
	编 号	STE-WI-022-04	制订日期	2025 年 07 月 10 日
	发行版次	V 1.0	页 次	第 6 页 共 15 页

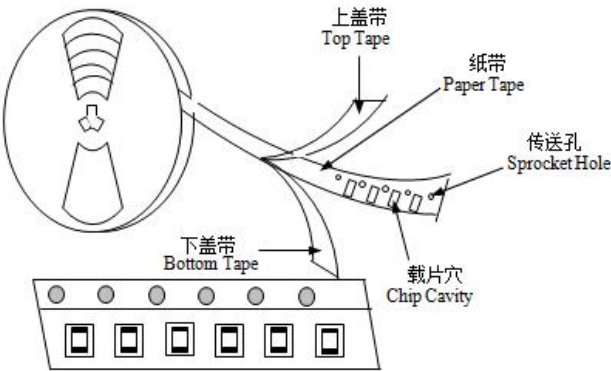
项目	测试方法及备注	要求															
温度周期	无负载于下表所示的环境条件下重复 5 次。 <table> <tr> <th>步骤</th><th>温度</th><th>时间</th></tr> <tr> <td>1</td><td>-40±5℃</td><td>30±3min</td></tr> <tr> <td>2</td><td>25±2℃</td><td>5±3min</td></tr> <tr> <td>3</td><td>125±2℃</td><td>30±3min</td></tr> <tr> <td>4</td><td>25±2℃</td><td>5±3min</td></tr> </table> 试验后标准条件下放置 1~2 小时后测量。	步骤	温度	时间	1	-40±5℃	30±3min	2	25±2℃	5±3min	3	125±2℃	30±3min	4	25±2℃	5±3min	无外观损伤； ΔR25/R25 ≤2% ΔB/B ≤1%
步骤	温度	时间															
1	-40±5℃	30±3min															
2	25±2℃	5±3min															
3	125±2℃	30±3min															
4	25±2℃	5±3min															
高低温冲击	一次回流焊预处理，-40℃/保温(30min)→+125℃/保温(30min)，温区转换时间 20s 以内，共 100 循环。	无外观损伤； ΔR25/R25 ≤2% ΔB/B ≤1%															
高温存放	在 125±5℃空气中，无负载放置 1000±24 小时。 试验后标准条件下放置 1~2 小时后测量。	无外观损伤； ΔR25/R25 ≤2% ΔB/B ≤1%															
低温存放	在-40±3℃空气中，无负载放置 1000±24 小时。 试验后标准条件下放置 1~2 小时后测量。	无外观损伤； ΔR25/R25 ≤2% ΔB/B ≤1%															
湿热存放	在 60±2℃，相对湿度 90~95%空气中，无负载放置 1000±24 小 时。 试验后标准条件下放置 1~2 小时后测量。	无外观损伤； ΔR25/R25 ≤2% ΔB/B ≤1%															
高温负荷	在 85±2℃空气中，施加允许工作电流 1000±48 小时。 试验后标准条件下放置 1~2 小时后测量。	无外观损伤； ΔR25/R25 ≤2% ΔB/B ≤1%															

	SMD 型片式热敏电阻器			
	编 号	STE-WI-022-04	制订日期	2025 年 07 月 10 日
	发行版次	V 1.0	页 次	第 7 页 共 15 页

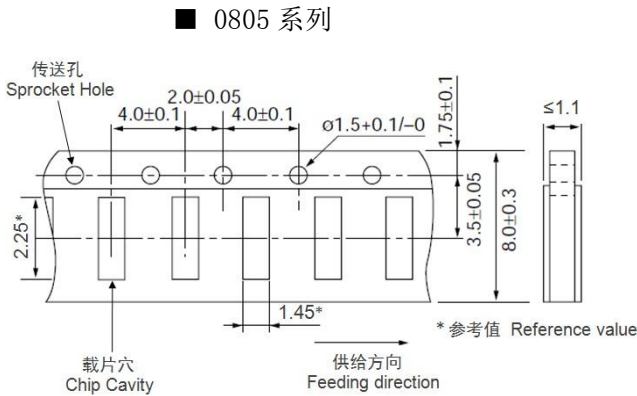
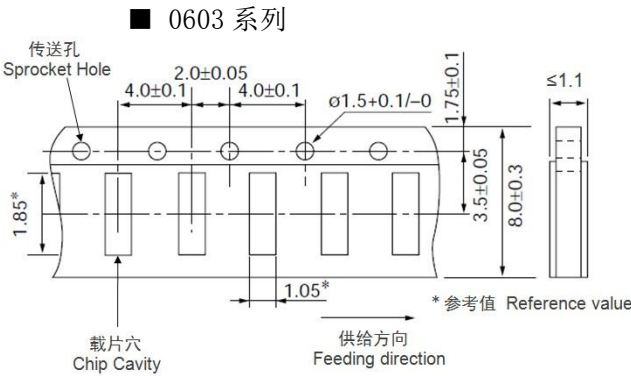
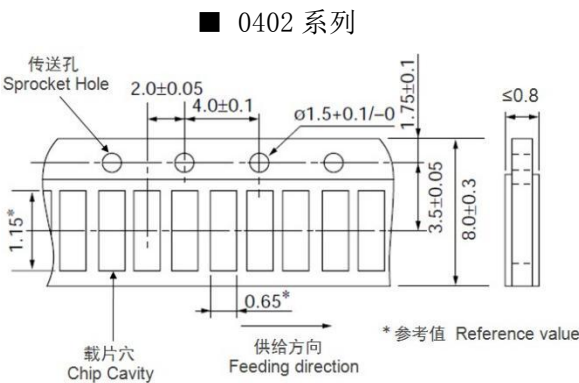
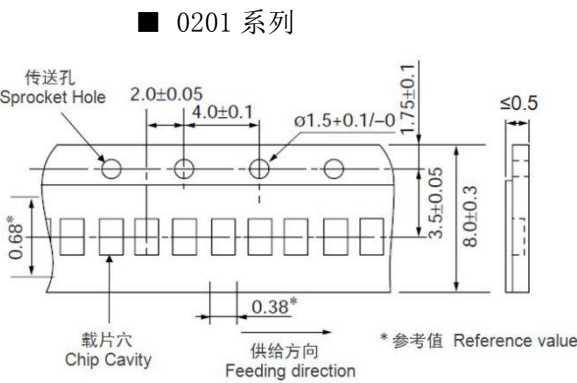
七、编带

类型	0201	0402	0603	0805
编带厚度	0.5±0.15	0.5±0.15	0.8±0.15	0.85±0.2
编带材质	纸带			
每盘数量	15K	10K	4K	4K

(1) 编带图

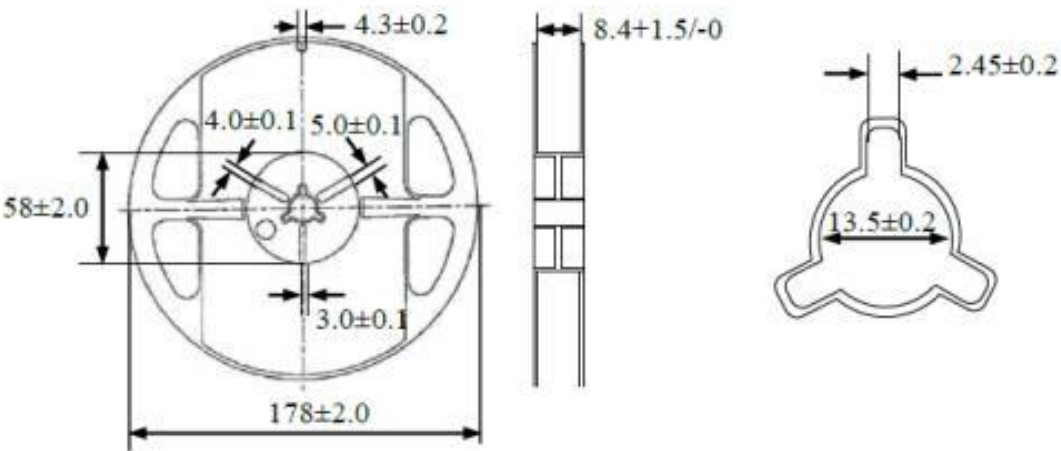


(2) 纸带尺寸



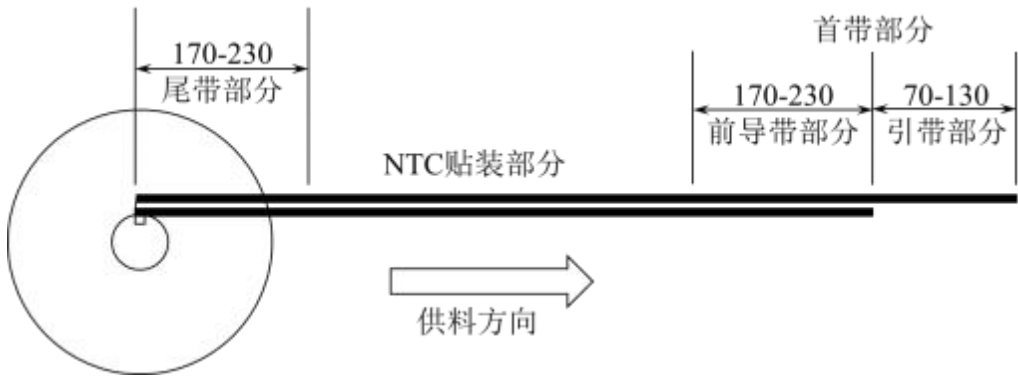
	SMD 型片式热敏电阻器			
	编 号	STE-WI-022-04	制订日期	2025 年 07 月 10 日
	发行版次	V 1.0	页 次	第 8 页 共 15 页

(3) 卷盘尺寸



(4) 编带包装方法

(4.1) 卷盘编带中包含未包装产品的首带、尾带部分，首带部分包含前导带部分和仅有上胶带或盖 带的引带部分，如下图所示。



单位：mm

- (4.2) 将上胶带和底带，或纸带和盖带贴在一起时，至少要留出前5 个中心距部分。
- (4.3) 卷盘上面应贴上标签。（标签上应标记敏瓷的产品型号、批号、检验号和数量。）
- (4.4) 编带卷盘后续需要经过内包装盒和外包装箱的包装，并贴上相应的标签，才能进行发货。

八、警告/注意事项

8.1 警告（保管和使用条件）

产品适用于普通环境中（常温，常湿，常压）。

● 产品不可在以下条件下工作，因为所有这些因素均会导致产品特性恶化或导致失效：

- (1) 腐蚀性气体或还原性气体(氯气、硫化氢气体、氨气、硫酸气体、一氧化氮等)。
- (2) 挥发性或易燃性气体
- (3) 多尘条件
- (4) 高压或低压条件
- (5) 潮湿场所
- (6) 存在盐水、油、化学液体或有机溶剂的场所
- (7) 强烈振动

	SMD 型片式热敏电阻器			
	编 号	STE-WI-022-04	制订日期	2025 年 07 月 10 日
	发行版次	V 1.0	页 次	第 9 页 共 15 页

(8) 存在类似有害条件的其他场所

- 产品属于易碎材料，使用时不可施加过大压力或冲击，否则可能会造成产品破裂或破碎。
- 产品不可在超过额定值的情况下工作。
- 请在规定的温度范围内使用本产品，温度过高时会导致产品特性或材料可能引起的继发损坏。
- 请务必在您的产品上配备适当的自动保险功能，以防止因产品功能异常或失效可能引起的继发 损坏。

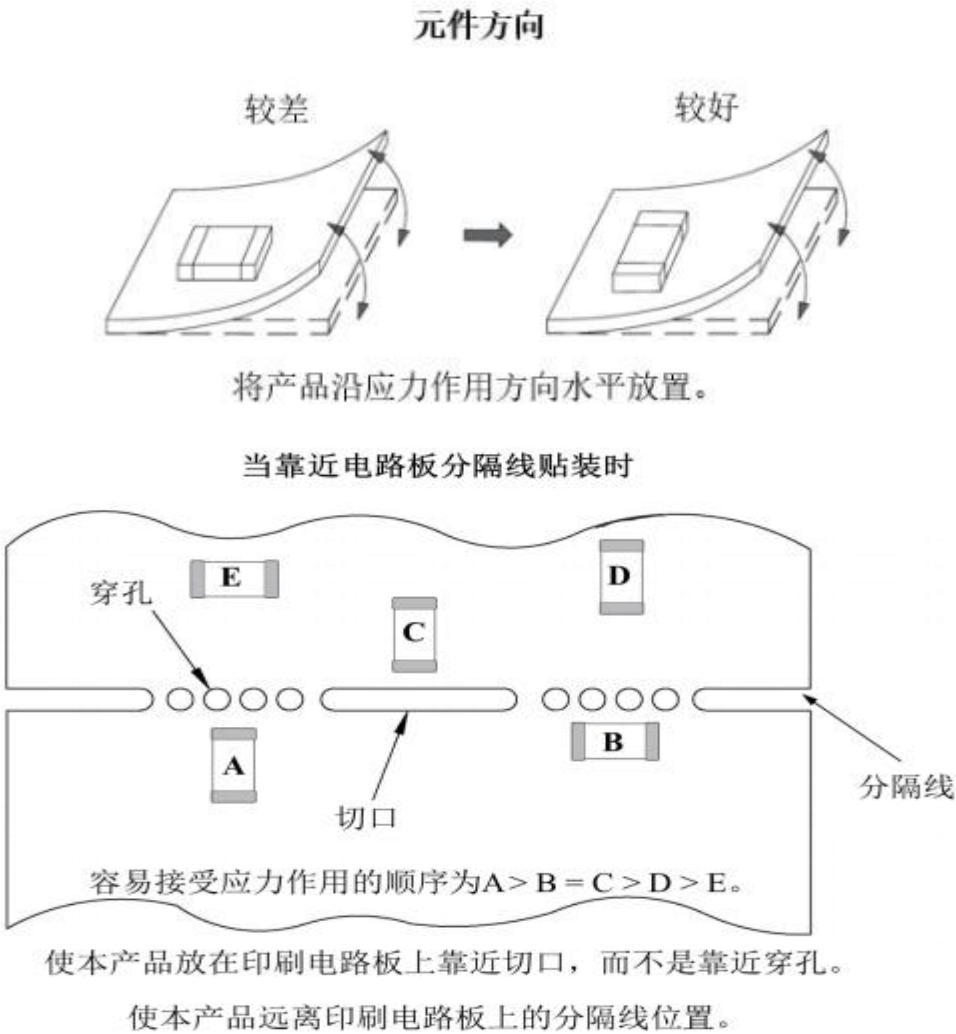
8.2 注意事项（存储）

为了保持产品的可焊性，建议采用以下存储条件。

- 存储条件：
 - (1) 存储温度：-10℃~+40℃
 - (2) 相对湿度： ≦75%RH（非结露）
 - (3) 避免接触粉尘、腐蚀性气氛和阳光
- 存储期限： 请通过先入先出库存方式，在产品交付后 6 个月内使用本产品。

8.3 注意事项（焊接与安装）

(1) 贴装位置 应选择适当的贴装位置，使电路板屈曲或弯折时施加在晶片上的应力最小。相关建议如下：



	SMD 型片式热敏电阻器			
	编 号	STE-WI-022-04	制订日期	2025 年 07 月 10 日
	发行版次	V 1.0	页 次	第 10 页 共 15页

(2) 推荐焊盘尺寸

单位：mm

尺寸（EIA）	a	b	c
0603	0.6~0.8	0.6~0.7	0.6~0.8

(3) 贴装到基板

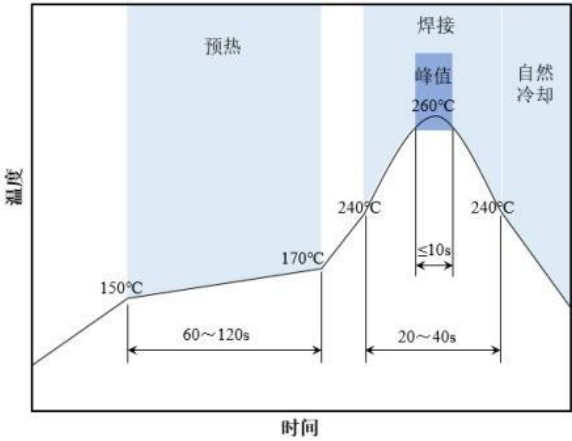
● 安装头的压力

- 如果吸附喷嘴的下止点过低，则贴装时 NTC 热敏电阻可能被施加过大的力，导致裂纹的产生， 因此使用时请参考：
- 1) 为了避免基板翘曲，请将吸附喷嘴的下止点设定于基板上并加以调整。
 - 2) 请将贴装时的喷嘴压力控制在静负荷时 0.1~0.3N。
 - 3) 为尽力缩小吸附喷嘴的冲击对基板的弯曲影响，请使支持销紧贴基板背面，抑制基板的弯曲。
 - 4) 定位爪磨损后可能导致定位时施加在 NTC 热敏电阻上的机械冲击具有局部性，导致 NTC 热敏电阻的缺失、开裂的发生，因此请对定位闭合尺寸进行管理，并且定期进行定位爪的维护、检 查以及更换。

(4) 建议焊接条件

- 回流焊
- 温升 1~2℃/sec.
- 预热：150~170℃/90±30 sec.
- 预热不足可能会导致陶瓷体破裂。曲线上预热温度与最高温度之间的差值应为 100℃。
- 大于 240℃时间：20~40sec
- 峰值温度：最高 260℃/10 sec.
- 焊膏：96.5wt%Sn/3.0wt%Ag/0.5wt%Cu
- 助焊剂：焊接时应使用松香助焊剂。

若使用强酸性助焊剂（卤化物含量超过 0.1wt%）或水溶性助焊剂（非树脂型助焊剂，包括水洗型 助焊剂和非水洗型助焊剂），则可能造成产品特性和可靠性方面问题。

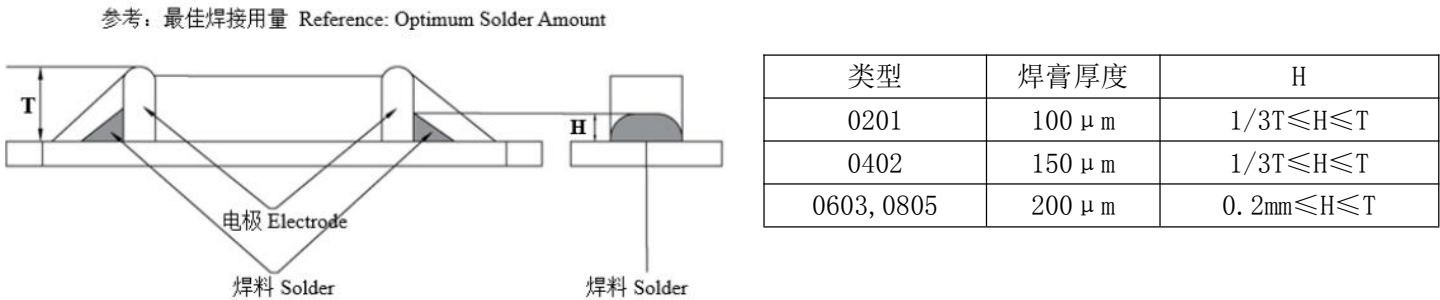


	SMD 型片式热敏电阻器			
	编 号	STE-WI-022-04	制订日期	2025 年 07 月 10 日
	发行版次	V 1.0	页 次	第 11 页 共 15 页

- 回流焊：最多 2 次。
两次焊接峰值温度累积时间必须控制在 30 秒内。
- 冷却：在空气逐渐冷却。不建议将元件浸泡溶剂或使用其他方法来快速冷却。
- 不符合焊接条件可能会造成金属分解或外部电极上的焊料湿润程度变差。

（5）焊膏的印刷条件

- 焊膏用量至关重要。下表列出了焊角的标准高度。



（6）焊接完成后

焊接完成后要清除助焊剂时，请遵循以下几点，以免造成特性退化或导致外部电极质量变化。

- 1) 进行超声清洗时，请防止安装部分与基板发生共振。
- 2) 在使用了非水洗型助焊剂时，请勿清洗产品。

类型	0201 0402	0603 0805
溶剂	异丙醇	
浸泡清洗	5 分钟（常温）或者 2 分钟（最高 40℃）	
超声波清洗	5 分钟以下，20W/L 频率 28kHz 到 40kHz	1 分钟以下，20W/L 频率 10kHz 到 100kHz

干燥
清洗之后，请迅速将本产品烘干。

	SMD 型片式热敏电阻器			
	编 号	STE-WI-022-04	制订日期	2025 年 07 月 10 日
	发行版次	V 1.0	页 次	第 12 页 共 15页

R-T 数据表

ST10603X103F3380FB

温度 (℃)	R 最小值 (kΩ)	R 中心值 (kΩ)	R 最大值 (kΩ)	阻值公差 (+)	阻值公差 (-)	温度公差 (+) (℃)	温度公差 (-) (℃)
-40	189.674	197.390	205.400	4.06%	3.91%	0.69	0.67
-39	179.349	186.540	194.000	4.00%	3.85%	0.69	0.66
-38	169.647	176.350	183.299	3.94%	3.80%	0.68	0.66
-37	160.550	166.800	173.276	3.88%	3.75%	0.68	0.65
-36	151.990	157.820	163.857	3.83%	3.69%	0.67	0.65
-35	143.951	149.390	155.019	3.77%	3.64%	0.67	0.65
-34	136.431	141.510	146.763	3.71%	3.59%	0.66	0.64
-33	129.347	134.090	138.993	3.66%	3.54%	0.66	0.64
-32	122.680	127.110	131.687	3.60%	3.49%	0.65	0.63
-31	116.391	120.530	124.804	3.55%	3.43%	0.65	0.63
-30	110.472	114.340	118.332	3.49%	3.38%	0.64	0.62
-29	104.913	108.530	112.260	3.44%	3.33%	0.64	0.62
-28	99.658	103.040	106.526	3.38%	3.28%	0.63	0.61
-27	94.706	97.870	101.129	3.33%	3.23%	0.63	0.61
-26	90.029	92.989	96.037	3.28%	3.18%	0.62	0.60
-25	85.611	88.381	91.231	3.23%	3.13%	0.62	0.60
-24	81.443	84.036	86.702	3.17%	3.09%	0.61	0.59
-23	77.504	79.931	82.426	3.12%	3.04%	0.60	0.59
-22	73.779	76.052	78.387	3.07%	2.99%	0.60	0.58
-21	70.256	72.384	74.569	3.02%	2.94%	0.59	0.58
-20	66.922	68.915	70.961	2.97%	2.89%	0.59	0.57
-19	63.767	65.634	67.549	2.92%	2.85%	0.58	0.57
-18	60.779	62.529	64.323	2.87%	2.80%	0.58	0.56
-17	57.949	59.589	61.269	2.82%	2.75%	0.57	0.56
-16	55.268	56.804	58.377	2.77%	2.70%	0.56	0.55
-15	52.726	54.166	55.640	2.72%	2.66%	0.56	0.54
-14	50.315	51.665	53.046	2.67%	2.61%	0.55	0.54
-13	48.029	49.294	50.588	2.62%	2.57%	0.55	0.53
-12	45.860	47.046	48.258	2.58%	2.52%	0.54	0.53
-11	43.801	44.913	46.049	2.53%	2.48%	0.53	0.52
-10	41.846	42.889	43.953	2.48%	2.43%	0.53	0.52
-9	39.989	40.967	41.964	2.43%	2.39%	0.52	0.51
-8	38.225	39.142	40.077	2.39%	2.34%	0.51	0.50
-7	36.549	37.408	38.284	2.34%	2.30%	0.51	0.50
-6	34.955	35.761	36.582	2.30%	2.25%	0.50	0.49
-5	33.440	34.196	34.965	2.25%	2.21%	0.49	0.48
-4	31.998	32.707	33.428	2.20%	2.17%	0.49	0.48
-3	30.627	31.291	31.966	2.16%	2.12%	0.48	0.47
-2	29.322	29.945	30.578	2.11%	2.08%	0.47	0.47
-1	28.080	28.664	29.257	2.07%	2.04%	0.47	0.46

	SMD 型片式热敏电阻器			
	编 号	STE-WI-022-04	制订日期	2025 年 07 月 10 日
	发行版次	V 1.0	页 次	第 13 页 共 15页

温度 (℃)	R 最小值 (kΩ)	R 中心值 (kΩ)	R 最大值 (kΩ)	阻值公差 (+)	阻值公差 (-)	温度公差 (+) (℃)	温度公差 (-) (℃)
0	26.898	27.445	28.001	2.02%	1.99%	0.46	0.45
1	25.770	26.283	26.804	1.98%	1.95%	0.45	0.45
2	24.696	25.177	25.665	1.94%	1.91%	0.45	0.44
3	23.673	24.124	24.581	1.89%	1.87%	0.44	0.43
4	22.699	23.121	23.549	1.85%	1.83%	0.43	0.43
5	21.769	22.165	22.566	1.81%	1.78%	0.42	0.42
6	20.882	21.253	21.628	1.76%	1.74%	0.42	0.41
7	20.037	20.384	20.735	1.72%	1.70%	0.41	0.40
8	19.230	19.555	19.883	1.68%	1.66%	0.40	0.40
9	18.460	18.764	19.071	1.64%	1.62%	0.39	0.39
10	17.725	18.010	18.297	1.60%	1.58%	0.39	0.38
11	17.024	17.290	17.559	1.55%	1.54%	0.38	0.38
12	16.353	16.602	16.853	1.51%	1.50%	0.37	0.37
13	15.713	15.946	16.181	1.47%	1.46%	0.36	0.36
14	15.101	15.319	15.538	1.43%	1.42%	0.36	0.35
15	14.517	14.720	14.925	1.39%	1.38%	0.35	0.35
16	13.958	14.148	14.339	1.35%	1.34%	0.34	0.34
17	13.424	13.601	13.779	1.31%	1.30%	0.33	0.33
18	12.913	13.078	13.244	1.27%	1.27%	0.32	0.32
19	12.424	12.578	12.733	1.23%	1.23%	0.32	0.31
20	11.955	12.099	12.243	1.19%	1.19%	0.31	0.31
21	11.508	11.642	11.776	1.15%	1.15%	0.30	0.30
22	11.079	11.204	11.329	1.11%	1.11%	0.29	0.29
23	10.669	10.785	10.901	1.08%	1.07%	0.28	0.28
24	10.276	10.384	10.492	1.04%	1.04%	0.27	0.27
25	9.900	10.000	10.100	1.00%	1.00%	0.27	0.27
26	9.532	9.632	9.732	1.04%	1.04%	0.28	0.28
27	9.180	9.280	9.380	1.08%	1.07%	0.29	0.29
28	8.843	8.943	9.042	1.11%	1.11%	0.30	0.30
29	8.520	8.619	8.718	1.15%	1.15%	0.31	0.31
30	8.211	8.309	8.408	1.19%	1.18%	0.33	0.32
31	7.914	8.012	8.110	1.22%	1.22%	0.34	0.34
32	7.630	7.727	7.824	1.26%	1.26%	0.35	0.35
33	7.357	7.453	7.550	1.30%	1.29%	0.36	0.36
34	7.096	7.191	7.287	1.33%	1.33%	0.37	0.37
35	6.845	6.939	7.034	1.37%	1.36%	0.39	0.38
36	6.604	6.698	6.792	1.41%	1.40%	0.40	0.40
37	6.373	6.466	6.559	1.44%	1.43%	0.41	0.41
38	6.152	6.243	6.335	1.48%	1.47%	0.43	0.42
39	5.939	6.029	6.120	1.51%	1.50%	0.44	0.43
40	5.735	5.824	5.914	1.55%	1.53%	0.45	0.45
41	5.538	5.627	5.716	1.58%	1.57%	0.46	0.46

	SMD 型片式热敏电阻器			
	编 号	STE-WI-022-04	制订日期	2025 年 07 月 10 日
	发行版次	V 1.0	页 次	第 14 页 共 15页

温度 (℃)	R 最小值 (k Ω)	R 中心值 (k Ω)	R 最大值 (k Ω)	阻值公差 (+)	阻值公差 (-)	温度公差 (+) (℃)	温度公差 (-) (℃)
42	5.350	5.437	5.525	1.62%	1.60%	0.48	0.47
43	5.169	5.255	5.342	1.65%	1.63%	0.49	0.48
44	4.995	5.080	5.165	1.69%	1.67%	0.50	0.50
45	4.828	4.911	4.996	1.72%	1.70%	0.52	0.51
46	4.667	4.749	4.832	1.75%	1.73%	0.53	0.52
47	4.512	4.593	4.675	1.79%	1.77%	0.54	0.54
48	4.363	4.443	4.524	1.82%	1.80%	0.56	0.55
49	4.220	4.299	4.379	1.86%	1.83%	0.57	0.56
50	4.083	4.160	4.239	1.89%	1.86%	0.58	0.58
51	3.950	4.027	4.104	1.92%	1.90%	0.60	0.59
52	3.823	3.898	3.974	1.96%	1.93%	0.61	0.60
53	3.700	3.774	3.849	1.99%	1.96%	0.63	0.62
54	3.582	3.654	3.728	2.02%	1.99%	0.64	0.63
55	3.468	3.539	3.612	2.05%	2.02%	0.65	0.64
56	3.358	3.429	3.500	2.09%	2.05%	0.67	0.66
57	3.252	3.322	3.392	2.12%	2.09%	0.68	0.67
58	3.151	3.219	3.288	2.15%	2.12%	0.70	0.68
59	3.052	3.119	3.188	2.18%	2.15%	0.71	0.70
60	2.958	3.024	3.091	2.22%	2.18%	0.72	0.71
61	2.867	2.931	2.997	2.25%	2.21%	0.74	0.73
62	2.779	2.842	2.907	2.28%	2.24%	0.75	0.74
63	2.694	2.756	2.820	2.31%	2.27%	0.77	0.75
64	2.612	2.673	2.736	2.34%	2.30%	0.78	0.77
65	2.533	2.593	2.655	2.37%	2.33%	0.80	0.78
66	2.457	2.516	2.576	2.40%	2.36%	0.81	0.80
67	2.383	2.441	2.501	2.43%	2.39%	0.83	0.81
68	2.312	2.369	2.428	2.46%	2.42%	0.84	0.83
69	2.244	2.300	2.357	2.50%	2.44%	0.86	0.84
70	2.177	2.233	2.289	2.53%	2.47%	0.87	0.85
71	2.113	2.168	2.223	2.56%	2.50%	0.89	0.87
72	2.052	2.105	2.159	2.59%	2.53%	0.90	0.88
73	1.992	2.044	2.098	2.62%	2.56%	0.92	0.90
74	1.934	1.986	2.038	2.65%	2.59%	0.93	0.91
75	1.879	1.929	1.981	2.68%	2.62%	0.95	0.93
76	1.825	1.874	1.925	2.71%	2.64%	0.96	0.94
77	1.773	1.821	1.871	2.73%	2.67%	0.98	0.96
78	1.722	1.770	1.819	2.76%	2.70%	1.00	0.97
79	1.673	1.720	1.768	2.79%	2.73%	1.01	0.99
80	1.626	1.673	1.720	2.82%	2.75%	1.03	1.00
81	1.581	1.626	1.672	2.85%	2.78%	1.04	1.02
82	1.537	1.581	1.627	2.88%	2.81%	1.06	1.03
83	1.494	1.538	1.582	2.91%	2.84%	1.08	1.05

	SMD 型片式热敏电阻器			
	编 号	STE-WI-022-04	制订日期	2025 年 07 月 10 日
	发行版次	V 1.0	页 次	第 15 页 共 15页

温度 (℃)	R 最小值 (kΩ)	R 中心值 (kΩ)	R 最大值 (kΩ)	阻值公差 (+)	阻值公差 (-)	温度公差 (+) (℃)	温度公差 (-) (℃)
84	1.453	1.496	1.540	2.94%	2.86%	1.09	1.07
85	1.413	1.455	1.498	2.97%	2.89%	1.11	1.08
86	1.374	1.416	1.458	2.99%	2.92%	1.13	1.10
87	1.337	1.377	1.419	3.02%	2.94%	1.14	1.11
88	1.300	1.340	1.381	3.05%	2.97%	1.16	1.13
89	1.265	1.304	1.345	3.08%	3.00%	1.17	1.14
90	1.231	1.270	1.309	3.11%	3.02%	1.19	1.16
91	1.198	1.236	1.275	3.13%	3.05%	1.21	1.18
92	1.167	1.204	1.242	3.16%	3.07%	1.23	1.19
93	1.136	1.172	1.209	3.19%	3.10%	1.24	1.21
94	1.106	1.141	1.178	3.22%	3.13%	1.26	1.22
95	1.076	1.112	1.148	3.24%	3.15%	1.28	1.24
96	1.048	1.083	1.118	3.27%	3.18%	1.29	1.26
97	1.021	1.055	1.090	3.30%	3.20%	1.31	1.27
98	0.995	1.028	1.062	3.32%	3.23%	1.33	1.29
99	0.969	1.002	1.035	3.35%	3.25%	1.35	1.31
100	0.944	0.976	1.009	3.38%	3.28%	1.36	1.32
101	0.920	0.951	0.984	3.40%	3.30%	1.38	1.34
102	0.897	0.927	0.959	3.43%	3.33%	1.40	1.36
103	0.874	0.904	0.935	3.46%	3.35%	1.42	1.37
104	0.852	0.882	0.912	3.48%	3.38%	1.43	1.39
105	0.830	0.860	0.890	3.51%	3.40%	1.45	1.41
106	0.810	0.838	0.868	3.53%	3.42%	1.47	1.42
107	0.790	0.818	0.847	3.56%	3.45%	1.49	1.44
108	0.770	0.798	0.826	3.59%	3.47%	1.50	1.46
109	0.751	0.778	0.806	3.61%	3.50%	1.52	1.47
110	0.733	0.759	0.787	3.64%	3.52%	1.54	1.49
111	0.715	0.741	0.768	3.66%	3.54%	1.56	1.51
112	0.697	0.723	0.750	3.69%	3.57%	1.58	1.53
113	0.680	0.706	0.732	3.71%	3.59%	1.60	1.54
114	0.664	0.689	0.715	3.74%	3.61%	1.61	1.56
115	0.648	0.673	0.698	3.76%	3.64%	1.63	1.58
116	0.633	0.657	0.682	3.79%	3.66%	1.65	1.60
117	0.618	0.641	0.666	3.81%	3.68%	1.67	1.61
118	0.603	0.626	0.650	3.84%	3.71%	1.69	1.63
119	0.589	0.612	0.635	3.86%	3.73%	1.71	1.65
120	0.575	0.598	0.621	3.89%	3.75%	1.73	1.67
121	0.562	0.584	0.607	3.91%	3.77%	1.75	1.69
122	0.549	0.570	0.593	3.93%	3.80%	1.77	1.70
123	0.536	0.557	0.579	3.96%	3.82%	1.79	1.72
124	0.524	0.545	0.566	3.98%	3.84%	1.80	1.74
125	0.512	0.532	0.554	4.01%	3.86%	1.82	1.76